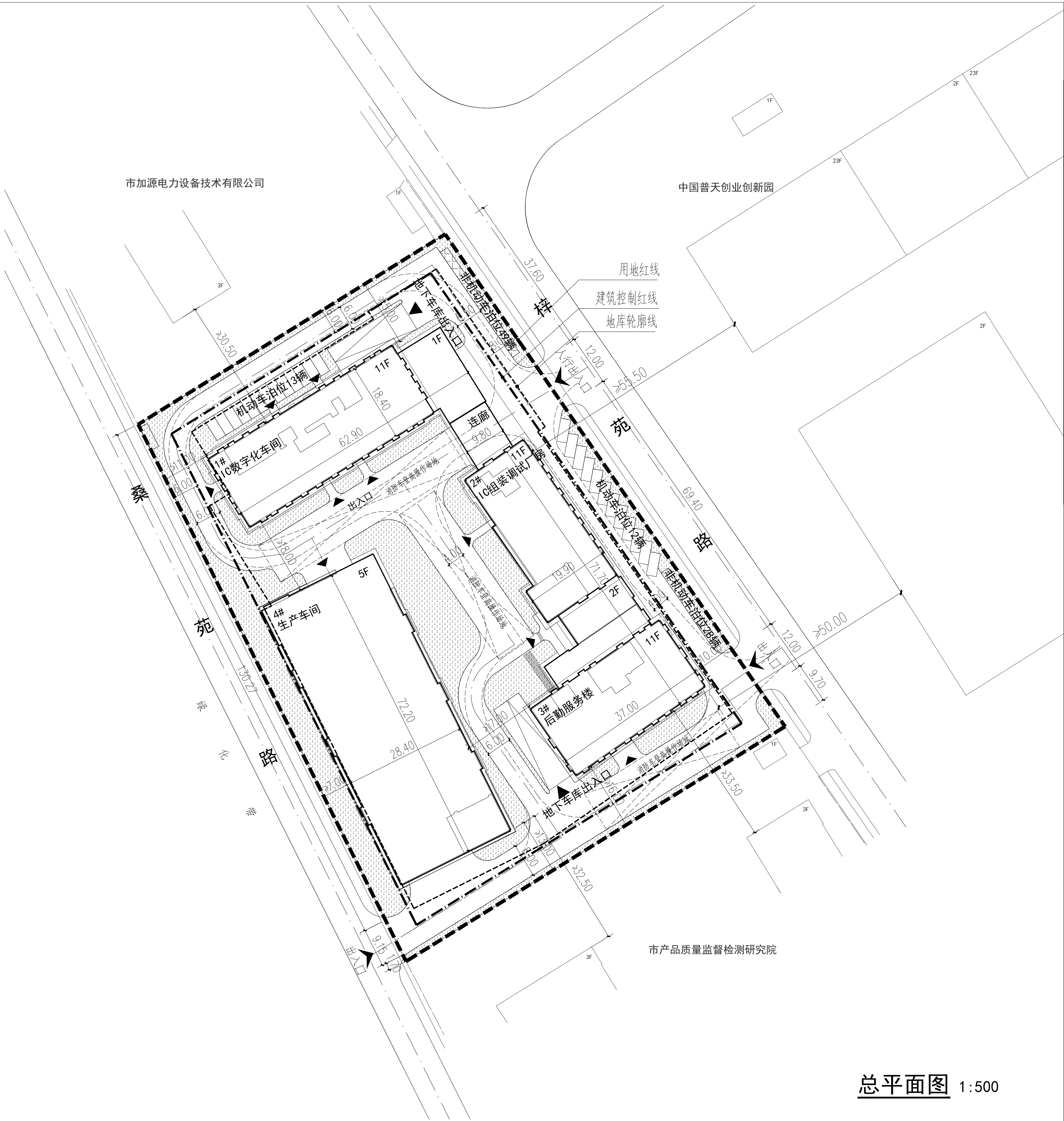


天津金海通半导体设备股份有限公司半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目建筑设计方案

总平面图草案公示



| 技术经济指标   |            |                    |         |       |    |          |          |         |   |  |
|----------|------------|--------------------|---------|-------|----|----------|----------|---------|---|--|
| 项目       | 单位         | 总指标                |         | 已发证指标 |    | 本次申报指标   |          | 审批后剩余指标 |   |  |
| 总用地面积    | m²         | 13333.7            |         | 0     |    | 13333.7  |          | 0       |   |  |
| 界内建设用地面积 | m²         | 13333.7            |         | 0     |    | 13333.7  |          | 0       |   |  |
| 界外建设用地面积 | m²         | 0.00               |         | 0     |    | 0.00     |          | 0       |   |  |
| 容积率      | -          | ≤                  | 2.88    | -     |    | -        |          | -       |   |  |
| 地上计容建筑面积 | m²         | ≤                  | 38443.5 | ≤     | 0  | ≤        | 38443.5  | ≤       | 0 |  |
| 建筑密度     | %          | ≥                  | 37%     | -     |    | -        |          | -       |   |  |
| 建筑基底面积   | m²         | ≥                  | 4939.80 | ≤     | 0  | ≥        | 4939.80  | ≤       | 0 |  |
| 绿地率      | -          | =                  | 20%     | =     | -  | =        | -        | =       | - |  |
| 绿地面积     | m²         | =                  | 2666.75 | =     | 0  | =        | 2666.75  | =       | 0 |  |
| 项目       |            |                    |         | 单位    |    | 本次申报指标   |          |         |   |  |
| 总建筑面积    |            |                    |         | m²    | ≤  | 48197.90 |          |         |   |  |
| 地上建筑面积   |            |                    |         | m²    | ≤  | 38443.50 |          |         |   |  |
| 其中       | 地上计容建筑面积   |                    |         | m²    | ≤  | 38443.50 |          |         |   |  |
|          | 其中         | 性质1- 生产建筑面积        |         |       | m² | ≤        | 30159.50 |         |   |  |
|          |            | 性质2- 配套行政办公及生活服务设施 |         |       | m² | ≤        | 8284.00  |         |   |  |
|          | 地上鼓励兼容建筑面积 |                    |         | m²    | ≤  | -        |          |         |   |  |
|          | 其中         | 性质1 建筑面积           |         |       |    |          | -        |         |   |  |
|          |            | 性质2 建筑面积           |         |       |    |          | -        |         |   |  |
| 地下建筑面积   |            |                    |         | m²    | ≤  |          |          |         |   |  |
| 经营性建筑面积  |            |                    |         | m²    | ≤  |          |          |         |   |  |
| 非经营性建筑面积 |            |                    |         | m²    |    | 9754.40  |          |         |   |  |
| 机动车停车位   |            |                    |         | 辆     | ≥  | 225      |          |         |   |  |
| 其中       | 地上机动车停车位   |                    |         | 辆     |    | 25       |          |         |   |  |
|          | 地下机动车停车位   |                    |         | 辆     |    | 200      |          |         |   |  |
| 非机动车停车位  |            |                    |         | 辆     | ≥  | 77       |          |         |   |  |
| 其中       | 地上非机动车停车位  |                    |         | 辆     |    | 77       |          |         |   |  |
|          | 地下非机动车停车位  |                    |         | 辆     |    | 0        |          |         |   |  |

图例

- 总用地范围
- 建筑退界线
- 1# 11F

建筑楼号及层数
- 园区出入口
- 机动车停车位
- 建筑出入口
- 非机动车停车位
- 消防流线
- 绿地
- 道路中心线
- 地下坡道入口
- 地下范围

公示单位：天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局

联系人：马梁                      联系电话：84800040

建设单位：天津金海通半导体设备股份有限公司

联系人：韩阁                      联系电话：89129719

设计单位：上海联创设计集团股份有限公司

联系人：王伟                      联系电话：58851085

总平面图 1:500